

# Cuペースト ACP-100M-1

Conductive Copper Paste ACP-100M-1

## 特徴 Features/特徴

- **125°C-60minでの低温硬化で良好な導電性を実現。**  
Able to realize excellent conductivity at low curing condition of 125°C -60min./在125°C -60分鐘的低溫固化下能實現良好的導電性。
- **微細銅粉末の使用により、解像性に優れた印刷が可能。**  
Capable of high-resolution printing through the use of fine particle copper powder./由於使用細微銅粉末,可以達成解析度優越的印刷

## 仕様 Specifications/規格

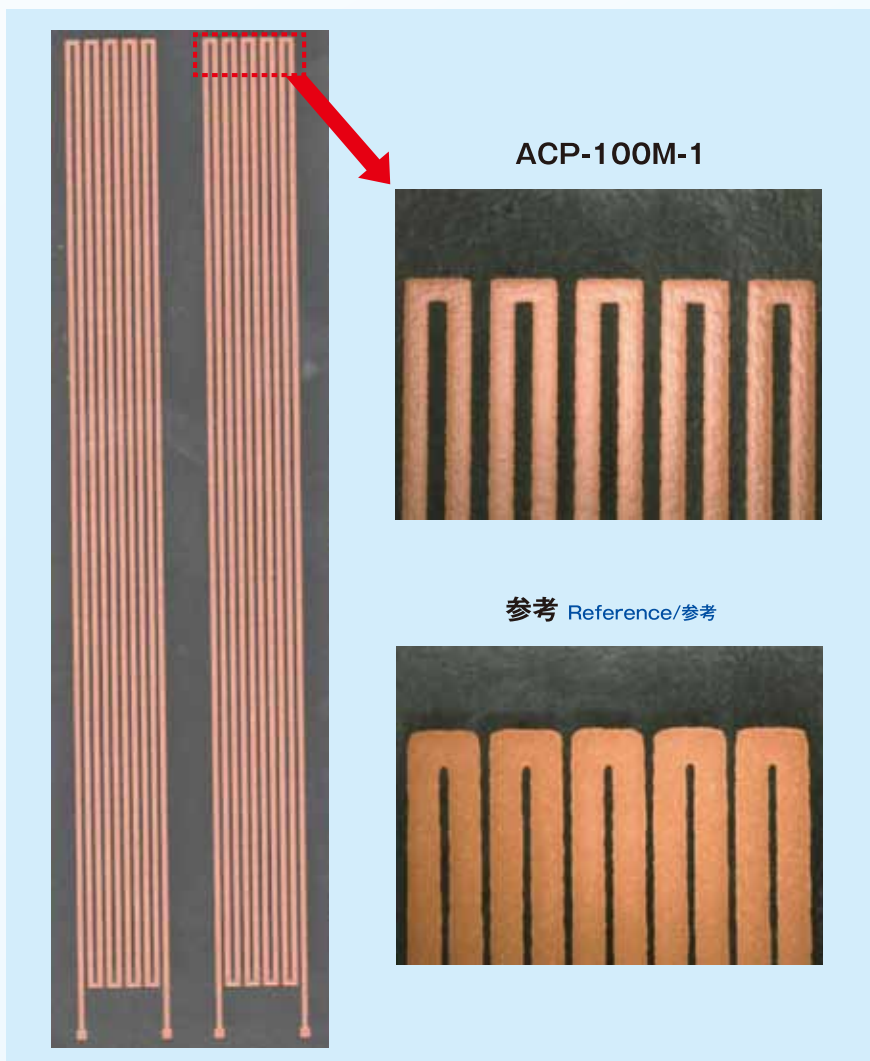
特性項目 Characteristic items/特性項目	<b>NEW</b> ACP-100M-1	備考 Remarks/備注
粘度 (25°C) Viscosity/粘度	<b>970 dPa·s</b>	<b>VT-06型粘度計</b> Viscotester VT-06type/VT-06型粘度計
硬化条件 Curing condition/固化條件	<b>125°C×60min</b> <b>150°C×30min</b>	<b>熱風循環式乾燥炉</b> Circulating heat oven/熱風循環式乾燥炉
体積固有抵抗値 Volume resistivity/體積固有阻抗値	<b>≤1.0E-4Ω·cm</b>	<b>125°C×60分硬化</b> Curing at 125°C for 60min/125°C×60分固化
	<b>≤7.0E-5Ω·cm</b>	<b>150°C×30分硬化</b> Curing at 150°C for 30min/150°C×30分固化
密着性 Adhesion/密著性	<b>100/100 (FR-4)</b>	<b>クロスカットテープピール</b> Cross-cut, tape peel/百格膠帶測試

## 用途 Application/用途

- **ジャンパー回路、電極、接点作製用**  
For formation of jumper circuit, electrode, or contact point/跳線回路,電極,接點製作用

## 印刷物 Printed Example/印刷物

印刷パターン Printed patten/印刷圖樣：**0.5mm×1000mm**  
乳剤厚 Emulsion thickness/乳劑厚度：**10μm**  
メッシュサイズ Mesh size/網目尺：**180M**



印刷パターン Printed patten/印刷圖樣：**0.2~1.0mm width**  
乳剤厚 Emulsion thickness/乳劑厚度：**5μm**  
メッシュサイズ Mesh size/網目尺：**400M**

